

当前位置: 科技频道首页 >> 军民两用 >> 计算机与网络 >> IC卡（存储器）芯片UV胶封装大生产技术研究

请输入查询关键词

科技频道

搜索

IC卡（存储器）芯片UV胶封装大生产技术研究

关键词: **IC卡** **胶封装** **生产技术**

所属年份: 2002

成果类型: 应用技术

所处阶段: 成熟应用阶段

成果体现形式: 新技术

知识产权形式:

项目合作方式: 其他

成果完成单位: 上海长丰智能卡有限公司

成果摘要:

本专题是将（4~8）英寸硅片减薄至（0.2mm），载带上芯片焊接后须在2~3分钟快速固化，金丝球焊保证低弧度0.13mm，UV胶封装后模块厚度≤0.58mm，密封胶面积<48.9平方毫米。模块技术指标符合ISO7816，经得起一定强度的扭、弯力，滴胶温度、速率、针阀流量、固化时间及强度等达到最佳参数，保证产品的质量和可靠性，有利于提高现代化管理水平和人民生活质量，前景可观。

成果完成人: 叶柏海;丁富强;周宗涛;顾旭光;陆高义;揭武信

[完整信息](#)

行业资讯

- 新疆综合信息服务平台
- 准噶尔盆地天然气勘探目标评价
- 维哈柯俄多文种操作系统FOR ...
- 社会保险信息管理系统
- 塔里木石油勘探开发指挥部广...
- 四合一多功能信息管理卡MISA...
- 数字键盘中文输入技术的研究
- 软开关高效无声计算机电源
- 邮政报刊发行订销业务计算机...
- 新疆主要农作物与牧草生长发...

成果交流

推荐成果

- [液压负载模拟器](#) 04-23
- [新一代空中交通服务平台、关...](#) 04-23
- [Adhoc网络中的QoS保证\(Wirel...](#) 04-23
- [电信增值网业务创意的构思与开发](#) 04-23
- [飞腾V基本图形库的研究与开发...](#) 04-23
- [ChinaNet国际\(国内\)互联的策...](#) 04-23
- [电信企业客户关系管理\(CRM\)系...](#) 04-23
- [“易点通”餐饮管理系统YDT2003](#) 04-23
- [MEMS部件设计仿真库系统](#) 04-23

Google提供的广告

>> 信息发布

版权声明 | 关于我们 | 客户服务 | 联系我们 | 加盟合作 | 友情链接 | 站内导航 | 常见问题

国家科技成果网

京ICP备07013945号